

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 26 年 3 月 20 日 (2014.3.20)

【公開番号】特開 2012-164469 (P2012-164469A)

【公開日】平成 24 年 8 月 30 日 (2012.8.30)

【年通号数】公開・登録公報 2012-034

【出願番号】特願 2011-22735 (P2011-22735)

【国際特許分類】

H 0 1 R 33/76 (2006.01)

【F I】

H 0 1 R 33/76 5 0 5 C

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 1 月 30 日 (2014.1.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

その内部において延伸するとともに第 1 配列パターンを形成する複数の第 1 導電性コンタクトピンを有する第 1 基板と、

その内部において延伸するとともに前記第 1 配列パターンとは異なる第 2 配列パターンを形成する複数の第 2 導電性コンタクトピンを有する第 2 基板であって、各第 2 導電性コンタクトピンが 1 つの第 1 導電性コンタクトピンに対応した第 2 基板と、

前記第 1 及び第 2 基板の間に配置され、その内部に複数の導電路を有する第 3 基板であって、各導電路が 1 つの第 1 導電性コンタクトピンをその対応する第 2 導電性コンタクトピンに電氣的に接続する第 3 基板と、

を備えた IC デバイス用ソケットであって、

前記第 3 基板は、前記第 1 基板及び前記第 2 基板のうち少なくともいずれかから分離されていることを特徴とする IC デバイス用ソケット。

【請求項 2】

前記第 3 基板は、前記第 1 及び第 2 基板から分離されていることを特徴とする請求項 1 記載の IC デバイス用ソケット。

【請求項 3】

前記第 1 ~ 第 3 基板を支持するボディであって、検査すべき IC デバイスを前記第 1 基板の面上の所定位置に配置するためのガイド部と、前記第 1 ~ 第 3 基板の相対位置の変動を最小にする構造と、を有するボディを更に備えたことを特徴とする請求項 1 記載の IC デバイス用ソケット。

【請求項 4】

前記第 1 基板は、前記第 2 基板に対面する下面と、該下面に対向する上面と、該上面から該下面に向かって伸びる複数の孔であって、1 つの対応した第 1 導電性コンタクトピンの少なくとも一部がそれぞれ挿入された複数の孔と、該上面及び下面の少なくともいずれかの上又は上方に設けられた保持部材とを有し、

前記保持部材は、1 つの対応する第 1 導電性コンタクトピンの一部がそれぞれ挿入される複数の貫通孔であって、前記複数の第 1 導電性コンタクトピンそれぞれの長手方向の軸を前記第 1 基板の対応する孔の中心軸に略一致させる複数の貫通孔を有し、

前記第 1 基板における各孔の内面上には、導体部材が設けられ、

前記複数の第 1 導電性コンタクトピンのうち少なくともいずれかは、前記第 1 基板における対応する孔の内面に設けられた前記導体部材と電氣的に絶縁されるように、該対応する孔に挿入されていることを特徴とする請求項 1 記載の IC デバイス用ソケット。

【請求項 5】

前記対応する孔の内面上に設けられた前記導体部材と、該対応する孔に挿入された第 1 導電性コンタクトピンとの間隙に、誘電体が配置されたことを特徴とする請求項 4 記載の IC デバイス用ソケット。

【請求項 6】

前記第 2 基板は、前記第 1 基板に対面する上面と、該上面に対向する下面と、該下面から該上面に向かって伸びる複数の孔であって、1 つの対応した第 2 導電性コンタクトピンの少なくとも一部がそれぞれ挿入された複数の孔と、該下面及び上面の少なくともいずれかの上又は上方に設けられた保持部材とを有し、

前記保持部材は、1 つの対応する第 2 導電性コンタクトピンの一部がそれぞれ挿入される複数の貫通孔であって、前記複数の第 2 導電性コンタクトピンそれぞれの長手方向の軸を前記第 2 基板の対応する孔の中心軸に略一致させる複数の貫通孔を有し、

前記第 2 基板における各孔の内面上には、導体部材が設けられ、

前記複数の第 2 導電性コンタクトピンのうち少なくともいずれかは、前記第 2 基板における対応する孔の内面に設けられた前記導体部材と電氣的に絶縁されるように、該対応する孔に挿入されていることを特徴とする請求項 1 記載の IC デバイス用ソケット。

【請求項 7】

前記第 3 基板は、その内部に誘電体層と、第 1 基板側及び第 2 基板側の双方から該誘電体層を挟む一对の導電層とが包埋された構造を有することを特徴とする請求項 1 記載の IC デバイス用ソケット。

【請求項 8】

前記第 3 基板は、その内部にストリップライン及びマイクロストリップラインの少なくともいずれかが包埋された構造を有することを特徴とする請求項 1 記載の IC デバイス用ソケット。